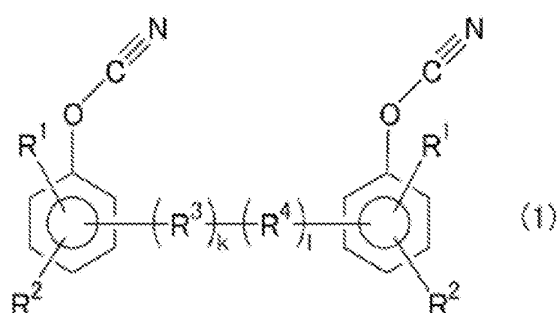


請求の範囲

- [請求項1] (A) シアネートエステル化合物、及び／又は (B) 不飽和イミド化合物と、
(C) 環状カルボジイミド化合物と
を含む、熱硬化性樹脂組成物。
- [請求項2] 前記 (A) シアネートエステル化合物を含む、請求項 1 に記載の熱硬化性樹脂組成物。
- [請求項3] 前記 (A) シアネートエステル化合物が、1 分子中に少なくとも 2 個のシアネート基を有する、請求項 2 に記載の熱硬化性樹脂組成物。
- [請求項4] 前記 (A) シアネートエステル化合物が、以下の式 (1) で表される化合物である、請求項 2 又は 3 に記載の熱硬化性樹脂組成物：

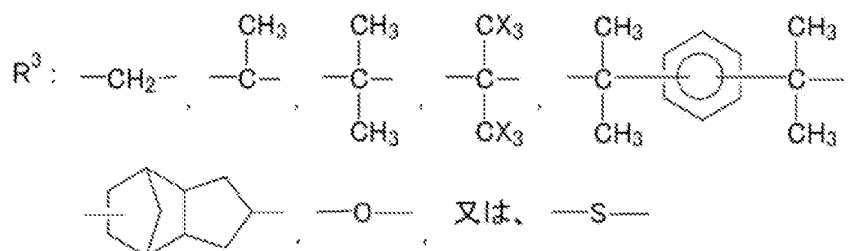
[化1]



(式中、 R^1 及び R^2 は、同一又は異なって、水素原子、炭素数 1 ～ 20 のアルキル基又はハロゲン化アルキル基、又はハロゲン基を表し；

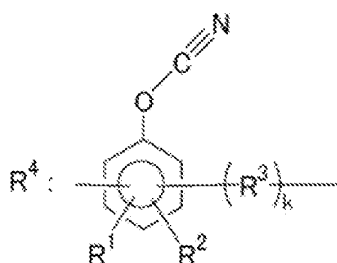
R^3 は、同一又は異なって、下記化学式で表される有機基を表し：

[化2]



R^4 は、同一又は異なって、下記化学式で表される有機基を表し：

[化3]



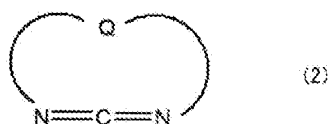
k は、0又は1であり；かつ l は、0～10の整数を表す）。

[請求項5] 前記（B）不飽和イミド化合物を含む、請求項1に記載の熱硬化性樹脂組成物。

[請求項6] 前記（B）不飽和イミド化合物が、ビスマレイミド化合物である、請求項5に記載の熱硬化性樹脂組成物。

[請求項7] 前記（C）環状カルボジイミド化合物が、下記一般式（2）で表される環状構造を少なくとも1つ含む化合物である、請求項1～6のいずれか一項に記載の熱硬化性樹脂組成物：

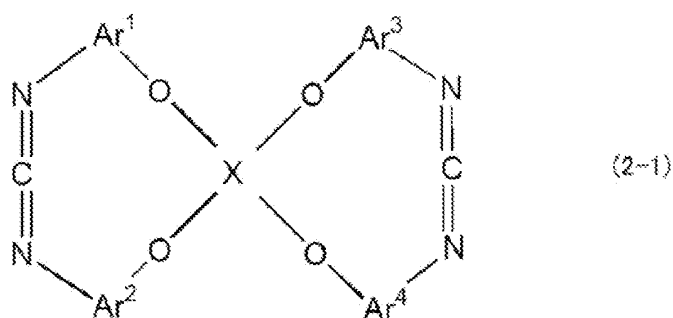
[化4]



（式中、 Q は、ヘテロ原子及び／又は置換基を含んでいてもよい、脂肪族基、脂環族基、芳香族基又はこれらの組み合わせである2～4価の結合基である）。

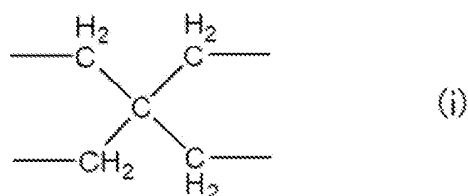
[請求項8] 前記（C）環状カルボジイミド化合物が、下記式（2-1）で表される化合物である、請求項1～7のいずれか一項に記載の熱硬化性樹脂組成物：

[化5]



(式中、Xは、下記式(i)で表される4価の基であり；

[化6]



$Ar^1 \sim Ar^4$ は、各々独立に、置換基を有していてもよい、2価の単環式若しくは縮合多環式の脂環式基、芳香族基、又は複素環基であり、ここで置換基は、炭素数1～20のアルキル基、炭素数6～15のアリール基、ハロゲン原子、ニトロ基、アミド基、ヒドロキシル基、エステル基、エーテル基、及びアルデヒド基からなる群より選択され、 $Ar^1 \sim Ar^4$ が複素環式基の場合、その複素環式基は、O、N、S、及びPからなる群より選択されるヘテロ原子を含む）。

[請求項9]

前記(A)シアネートエステル化合物、

前記(B)不飽和イミド化合物、及び

前記(C)環状カルボジイミド化合物

を含む、請求項1～8のいずれか一項に記載の熱硬化性樹脂組成物。

[請求項10]

前記(A)シアネートエステル化合物と前記(B)不飽和イミド化合物との合計100質量部に対して、前記(C)環状カルボジイミド化合物が、1～30質量部の範囲で含まれる、請求項9に記載の熱硬化性樹脂組成物。

- [請求項11] 前記（A）シアネートエステル化合物と前記（B）不飽和イミド化合物とを、90：10～50：50の質量比で含む、請求項9又は10に記載の熱硬化性樹脂組成物。
- [請求項12] 請求項1～11のいずれか一項に記載の熱硬化性樹脂組成物の硬化物を含む、成形品。
- [請求項13] 請求項1～11のいずれか一項に記載の熱硬化性樹脂組成物が強化繊維基材に含浸されている、プリプレグ。
- [請求項14] 請求項13に記載のプリプレグを硬化させた、繊維強化複合材料。